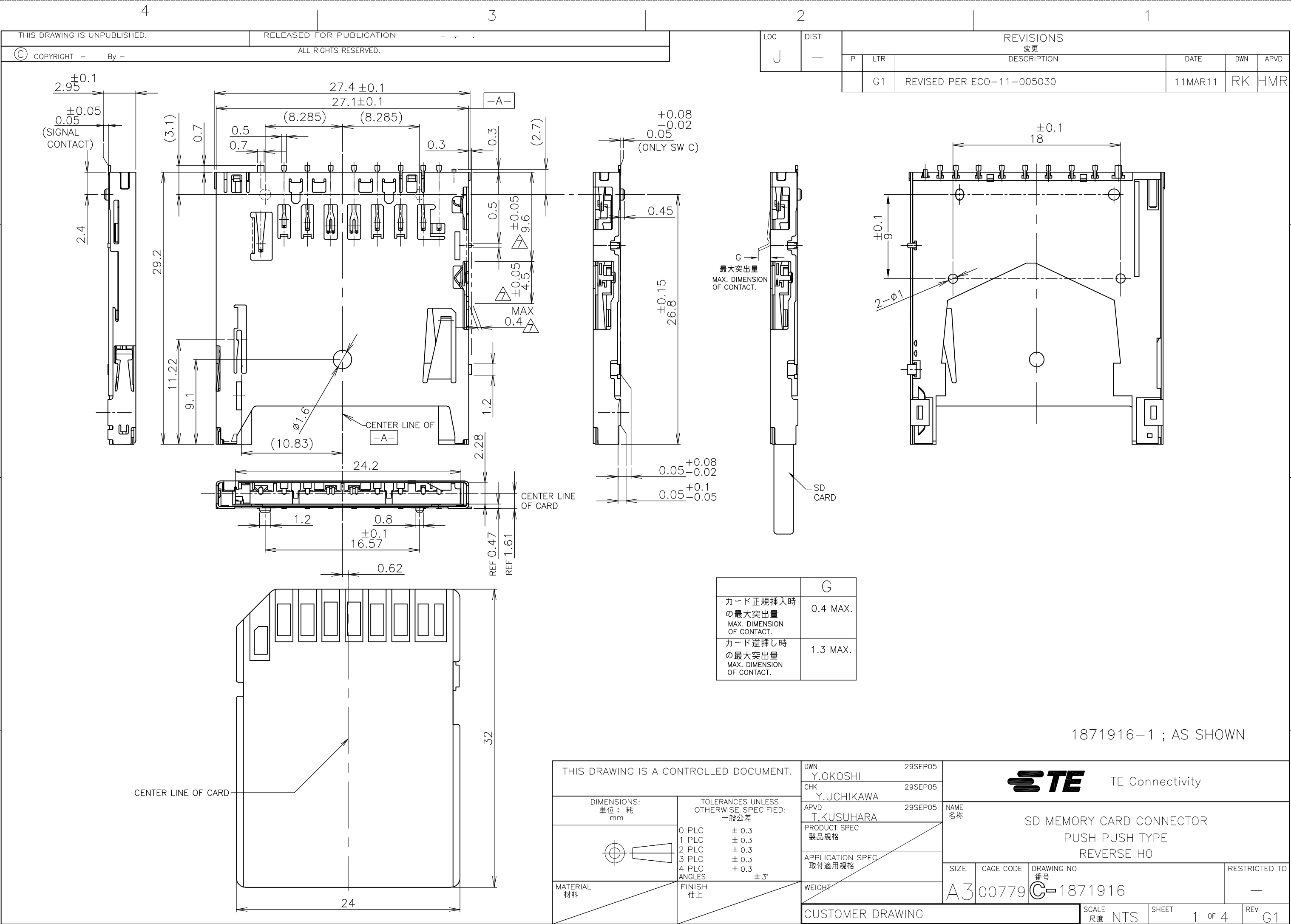
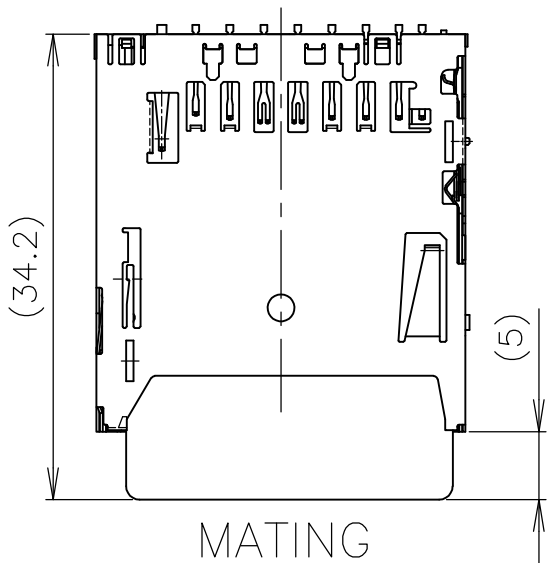
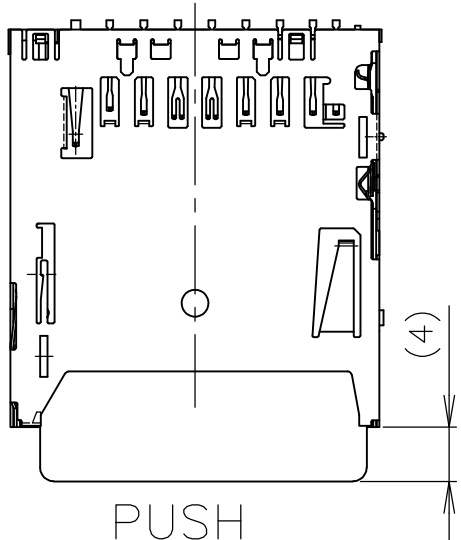




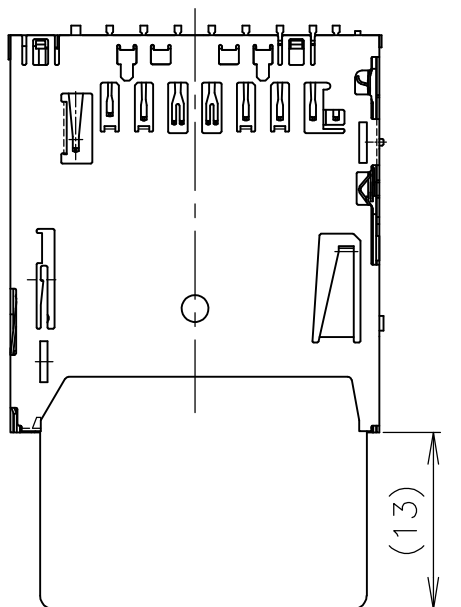
LOC	DIST	REVISIONS				DATE	DWN	APVD
		P	LTR	変更	DESCRIPTION			
J	—		—		SEE SHEET 1	—	—	—



MATING



PUSH



EJECT

注記

- △ カード認識スイッチ用
- △ コモン端子用
- △ ライトプロテクトスイッチ用
- 4 カード挿入時の接触の順番
PIN #3,4 → PIN #2,5,6,7,8,9
カード認識スイッチ ← PIN #1
- △ スwitchの回路図
- 6 本製品は浸漬による洗浄は行わないこと。
- 7 適合基板厚 0.6±0.1mm
- 8 コプラナリティは、0.1mm以下。
- 9 材料
ハウジング : LCP樹脂、UL94V-0、黒色
コンタクト : 銅合金
シェル : 銅合金 (t=0.2)
- 10 仕上げ
コンタクト : 接点部 : Ni下地めっき 2~4μm、Auめっき0.2~0.5μm。
 タイン : Snめっき 2~4μm。(無光沢)
 タイン : Auめっき 0.05~0.13μm。(コモン端子)
シェル : Cu 0.5μm.MIN. Snめっき(前めっき リフロー処理) 1μm.MIN.

NOTE

- △ FOR CARD DETECT SWITCH
- △ FOR COMMON TERMINAL
- △ FOR WRITE PROTECT SWITCH
- 4 THE SEQUENCE OF CONTACT DURING CARD INSERTION
PIN #3,4 → PIN #2,5,6,7,8,9
CARD DETECT SWITCH ← PIN #1
- △ CIRCUIT DRAWING OF SWITCH
- 6 DON'T WASH BY IMMERSING THE CONNECTOR IN FLUID
- 7 APPLICABLE BOARD THICKNESS :0.8±0.1mm
- 8 COPLANARITY IS 0.1MAX.
- 9 MATERIAL
HOUSING : LCP,UL94V-0,BLACK
CONTACT : COPPER ALLOY
SHELL : COPPER ALLOY (t=0.2)
- 10 FINISH
CONTACT : CONTACT AREA:Ni UNDER PLATING 2~4μm. Au PLATING 0.2~0.5μm。
 TINE : Sn PLATING 2~4μm。(NON LUSTER)
 TINE : Au PLATING 0.05~0.13μm.(COMMON TERMINAL)
SHELL : Cu 0.5μm.MIN. Sn PLATING(PRE-TIN REFLOW) 1μm.MIN.

1871916-1 ; AS SHOWN

